

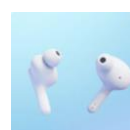
产品概述：

该芯片是一颗基于BT/BLE5.3双模协议栈以及BLE Audio标准开发的高规格蓝牙音频SoC。内置高性能HiFi 5 DSP和NPU，并集成Hybrid ANC，支持以极低功耗实现复杂的多麦克风上行降噪算法和语音唤醒。同时提供丰富的接口，集成度高，适用于高带宽、深降噪的高级TWS降噪耳机和其他需要复杂的音频处理和语音AI能力的低功耗产品。

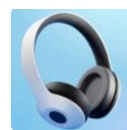
优势特性：

- 支持BT/BLE 5.3双模协议栈；
- 支持LE Audio新技术标准和 LC3 编解码器；
- 集成Hybrid (FF+FB) 混合式ANC主动降噪；
- 更大SRAM和FLASH空间，实现应用特性更广覆盖；
- 升级射频相关性能；
- 作为平台开放，支持更多产品形态；

应用领域：



TWS耳机



游戏耳机



蓝牙音箱

产品框图：

